

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: 0.25um 銅配線とエポキシの認定の件

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2012年7月20日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

Japan Regional Marketing

該当GPCN番号:

15278

変更内容:

リストにある対象デバイスのパッケージ品は、現在、南通富士通マイクロエレクトロニクス (NFMEC) で金配線でボンディングで組み立てが行われています。南通富士通マイクロエレクトロニクス (NFMEC) の材料として、現在の金配線に加えて銅配線を使用することをフリースケールで認定しました。銅配線とともにエポキシがAblestik 8325L から Yizbond 9246LBに変更されます。

変更理由:

銅配線のワイヤ・ボンディング材料の追加とともに、エポキシをAblestik 8325L から Yizbond 9246LBに変更。

対象製品:

MC9S08AC16CFGE
MC9S08AC16CFGER
MC9S08AC16MFGE
MC9S08AC32CFGE
MC9S08AC32CFGER
MC9S08AC32CPUE
MC9S08AC32CPUER
MC9S08AC32MFGE
MC9S08AC32MPUE
MC9S08AC32MPUER
MC9S08AC48CFGE
MC9S08AC48CFGER
MC9S08AC48CPUE
MC9S08AC48MFGE
MC9S08AC60CFGE
MC9S08AC60CFGER
MC9S08AC60CPUE
MC9S08AC60MFGE
MC9S08AC60MPUE
MC9S08AC8CFGE
MC9S08AC8CFGER
MC9S08AC8MFGE
MC9S08AW16CFGE
MC9S08AW16CFGER
MC9S08AW16CPUE
MC9S08AW16MFGE
MC9S08AW16MPUE
MC9S08AW16VFGE
MC9S08AW32CFGE
MC9S08AW32CFGER
MC9S08AW32CPUE
MC9S08AW32CPUER

MC9S08AW32MFGE
MC9S08AW32VFGE
MC9S08AW48CFGE
MC9S08AW48CFGER
MC9S08AW48CPUE
MC9S08AW60CFGE
MC9S08AW60CFGER
MC9S08AW60CPUE
MC9S08AW60CPUER
MC9S08AW60MFGE
MC9S08AW60MPUE
MC9S08AW60VFGE
MC9S08GB32ACFUE
MC9S08GB60ACFUE
MC9S08GB60ACFUER
MC9S08LL16CLH
MC9S08RE8CFGE
MC9S08RG32CFGE
MC9S08RG32FGE
MC9S08RG60CFGE
MC9S08RG60FGE
PCS8AC16EBCFGE
PCS8AC16EBMFGE
PCS8AC16J1CFGE
PCS8AC16J1MFGE
PCS8AC60EAMPUE
PCS8AC60J0MPUE
PCS8AC60W0MFGE
PCS8AC60W0MPUE
PCS8LL16J0CLH
SC9S8AW16J0CFGE
SC9S8AW16J0CFGER
SC9S8AW32J0CFGE
SC9S8AW32J0CFGER
SC9S8AW48J0CFGE
SC9S8AW48J0CFGER
SC9S8AW60J0CFGE
SC9S8AW60J0CFGER
SCS8AC16EACFGE
SCS8AC16EACFGER
SCS8AC16J0CFGE
SCS8AC32E0CFGE
SCS8AC32E0CFGER
SCS8AC32EACFGE
SCS8AC32EBCFGE
SCS8AC48E0CFGE
SCS8AC48E0CFGER
SCS8AC48EACFGE
SCS8AC48EBCFGE

SCS8AC60EACFGE SCS8AC60EACPUE SCS8AC60EAMFGE
--

変更（変更品出荷）時期：

変更開始日： 18-Oct-2012

変更品の見分け方：

--

その他：

形状、FIT値、信頼性の変更はありません。
